提案書

＜提案企業概要＞

*※以下の記載欄は、必要に応じて枠の大きさを調整してください。*

*※秘密情報は一切含めないでください。*

|  |  |
| --- | --- |
| ①貴社名 | ●●●●株式会社 |
| ②所在地 | （郵便番号）〒●●●-●●●● |
|  | （住所）●●● |
| ③資本金 | ●●●円 |
| ④従業員数 | ●●名（●年●月時点） |
| ⑤主要事業の内容 | ※貴社のパンフレットやカタログがございましたら、URLをご記入ください。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） |
| ⑥貴社HPのURL |  |
| ⑦本技術交流会の担当者連絡先 | 1 | 役職 |  |
|  |  | 氏名 |  |
|  |  | TEL |  |
|  |  | E-Mail |  |
|  | 2 | 役職 |  |
|  |  | 氏名 |  |
|  |  | TEL |  |
|  |  | E-Mail |  |
|  | 3 | 役職 |  |
|  |  | 氏名 |  |
|  |  | TEL |  |
|  |  | E-Mail |  |
| ⑧これまでの半導体関連事業の実績 |[ ]  実績あり |[ ]  実績なし |
| ⑨所属している半導体関連協議会・コンソーシアム※該当欄に☑をお付けください。 |[ ]  北海道半導体人材育成等推進協議会 |
|  |[ ]  東北半導体・エレクトロニクスデザインコンソーシアム(T-Seeds) |
|  |[ ]  関東半導体人材育成等連絡会議 |
|  |[ ]  中部地域半導体人材育成等連絡協議会 |
|  |[ ]  関西半導体人材育成等連絡協議会 |
|  |[ ]  中国地域半導体関連産業振興協議会 |
|  | □ | 九州半導体人材育成等コンソーシアム |
|  |[ ]  九州半導体・デジタルイベーション協議会(SIIQ) |
| ⑩確認事項※右記文章をご確認の上、右欄に☑をお付けください。 |[ ]  本提案書を・技術交流会事務局、ニーズ発信企業に提供すること・所属している半導体関連協議会・コンソーシアムに提供する場合があることをいずれも承諾いたします。 |

【面談可能日時】

*※選考後の技術交流会開催にあたり、ご提案企業様にあらかじめ面談日程の候補日確保をお願いしております。*

*※以下の候補から、5つ以上の日程・時刻をご選択くださいますようお願いいたします。（一次選考後、詳細な日程・時刻をご連絡いたします。*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面談時間※ | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 |
| （集合時間） | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 9:30 - 10:30（9:10） |  |  |  |  |  |
| 10:30 - 11:30（10:10） |  |  |  |  |  |
| 13:30 - 14:30（13:10） |  |  |  |  |  |
| 14:30 - 15:30（14:10） |  |  |  |  |  |
| 15:30 - 16:30（15:10） |  |  |  |  |  |
| 16:30 - 17:30（15:10） |  |  |  |  |  |

※上記面談時間には、控室から面談会場への移動時間等を含みます。（実質面談時間は50分/社）

【提案内容】

*※以下の記載欄は、必要に応じて枠の大きさを調整してください。*

*※必要に応じて画像、図、表などを挿入してください。*

*※資料のページ数については、１つの提案内容につき４ページ以内で記載してください。*

*※複数の提案を行う場合、3ページ目から4ページ目の様式を提案の個数分複製してご記入ください。*

１．提案技術・製品が、「応募要領（別紙）」に記載されたどのニーズに対応したものかご記載ください。

*※ニーズに対応していない場合は「―」とご記載ください。*

|  |  |
| --- | --- |
| ニーズ番号 |  |

2．提案技術・製品に関するテーマ/タイトルを「簡潔」に（30文字以内で）、ご記載ください。

|  |
| --- |
| （記載例）～～を効率化します！ ～～を革新します！ これまでにない～～！ 消費電力を●％削減します！ |
|  |

3．提案技術・製品の概要、特徴・既存技術・製品と比較した場合の優位性・実現方法、採用・導入実績、開発状況・研究段階、知的財産権の状況等をご記載ください。

*※全ての項目に記載していただく必要はなく、可能な範囲で記載をお願いします。*

*※その他自由に項目を追加いただいても結構です。*

|  |  |
| --- | --- |
| 概要 |  |
| 特徴・既存技術・製品と比較した場合の優位性・実現方法(材料・加工・組立・計測方法等) |  |
| 採用・導入実績 |  |
| 開発状況・研究段階 |  |
| 知的財産権の状況 |  |
| 販売ロット・単価・費用対効果 |  |

4．提案技術・製品の用途方法、用途場面等、技術・製品の用途イメージをご記載ください。

|  |
| --- |
| （記載例）～～～の場面で、～～～のように利用することで、～～～の結果が見込まれる。～～～の工程の～～～で利用することで効率化が図られる。 |
|  |

5．これまでの半導体関連事業の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記載ください。

*※半導体関連企業との取引実績、受賞歴、取組年数、技術を活用した製品例、提案技術の優位性など、保有技術のアピールになる点がありましたら、極力ご記載ください。*

|  |
| --- |
|  |

6．これまでの半導体関連事業以外の実績など、アピールしたい内容があれば自由にご記載ください。

|  |
| --- |
|  |

７．その他、特筆すべき事項があれば記載ください。（要望等、全てにお応えできない場合もございます）

|  |
| --- |
|  |

以上